

Requested Patent JP60182731

Title: SEMICONDUCTOR DEVICE

Abstracted Patent JP60182731

Publication Date: 1985-09-18

Inventor(s): KAWAGUCHI TAMOTSU

Applicant(s): TOSHIBA KK

Application Number: JP19840038086 19840229

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L21/60

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve area efficiency by bringing the size of a semiconductor chip on the upper side to a slightly small size and each connecting a semiconductor chip on the lower side to a conductor through wireless bonding and the upper side chip to it through wire bonding in two kinds of the semiconductor chips, the backs thereof are fixed mutually.

CONSTITUTION: When the backs of semiconductor chips 14' and 16' of two kinds are fixed mutually by using adhesives 15, the size of the upper chip 16' is previously made slightly larger than that of the lower chip 14'. When the lower chip 14' is connected to split conductors 12 formed on the surface of a substrate 11, solder bumps 13 are shaped at both ends of the lower surface of the chip 14', and the bumps 13 are each fixed to the conductors 12 through a face down. Metallic wires 17 are used in the chip 16', and the chip 16' is connected to several conductor 12 through a face up. Accordingly, a semiconductor device with a large number of connecting conductors is obtained without magnifying the size of the chips.



⑫ 公開特許公報 (A) 昭60-182731

⑬ Int. Cl.¹
H 01 L 21/60識別記号
厅内整理番号
6732-5F

⑭ 公開 昭和60年(1985)9月18日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

⑮ 発明の名称 半導体装置

⑯ 特 願 昭59-38086
⑰ 出 願 昭59(1984)2月29日

⑱ 発明者 川口 保 川崎市幸区堀川町72番地 東京芝浦電気株式会社堀川町工場内

⑲ 出願人 株式会社東芝 川崎市幸区堀川町72番地

⑳ 代理人 弁理士猪股清 外3名

明細書

1. 発明の名称 半導体装置

2. 特許請求の範囲

1. 互いに裏面どうしを固着した2種類の半導体チップを備え、一方の半導体チップはワイヤレスポンディングにより基板上の電極引出導体に接続され、他方の半導体チップはワイヤポンディングにより前記電極引出導体に接続された半導体装置。

2. ワイヤポンディングにより電極引出導体に接続される半導体チップの大きさがワイヤレスポンディングにより前記電極引出導体に接続される半導体チップの大きさよりも小さいものである特許請求の範囲第1項記載の半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

〔発明の技術分野〕

本発明は半導体装置に係り、特に半導体素子ベ

レットとリードフレーム間の配線が行われる半導体装置に関する。

〔発明の技術的背景〕

半導体装置はウェーハ上等真食刻技術等によつて多数形成された集積回路を分離して半導体チップとし、これをセラミック基板上またはリードフレームのベッドに搭載し、適当なシール等を行つてパッケージを形成している。

第1図かし第3図は従来使用されている半導体装置の代表的な形式を示した中心断面図であつて、第1図ではセラミック等の基板上に設けられた導体 λ の上に半導体チップ β がダイポンディングにより表面を上向き(フェースアップ)に面着されており、この半導体チップ β の電極はその周囲に配設された外側引出用導体 γ とポンディングワイヤ δ によって接続されている。

また第2図および第4図はポンディングワイヤを使用しない、いわゆるワイヤレスポンディングによる半導体装置を示す正面図であつて、第2図においてはセラミック等の基板上に設けられた

外部引出用導体6に半導体チップ8が表面を下向き(フェースダウン)にはんだ等の突起物であるパンプフを介して取付けられており、フリップチップ方式と称される。第3図はビームリーF方式の実装法を示すもので、半導体チップの基板部に微細な金のビーム状リード9をウェーハ工数で形成しておき、基板10上に形成された金導体バーナー11にフェースダウンで熱圧着されている。ワイヤレスボンディング方式には他に金パンプを有する半導体チップを長尺ボリュミドテープ12上に多数取付けたものから切断して使用するTAB(Tape Automated Bonding)方式等があり、それぞれ各数を有しているが、これらは単独で使用されるにすぎない。

〔背景技術の問題点〕

しかしながら、近年の半導体装置における高集成化に伴い半導体チップから引き出す導体の数は増加しつつあるが、このような多数の導体に対しても従来の構成では小さな半導体チップの周囲に配設できる導体の数に限界が生ずる。

の大きさを増加させることなく多数の引出導体との接続を可能ならしめるものである。

〔発明の実施例〕

以下、図面を参照しながら本発明の一実施例について詳細に説明する。

第4図は本発明の典型的な実施例を示す中央断面図であって、基板12A上に形成された導体13にははんだパンプ13Aによって半導体チップ14がフェースダウンで固定されており、この半導体チップ14の上には基板13によりもう一つの半導体チップ16がフェースアップで接続されている。半導体チップ16上の導体からは金またはアルミニウムのワイヤ17で導体12Aに対して電極が行われている。したがって2つの半導体チップ14Aおよび16Aは互いに裏面どうしが貼り合わされている。

第5図は第4図の組合を上面から見た図であって、放射状に形成された導体12Aは半導体チップ14の下まで伸び、第4図に示したようにはんだパンプ13を介してワイヤレスボンディングにより接続されている。導体12A間に形成された導体12B

半導体チップの周囲に配設される導体の数を増加させる手段として導体の先端位置を半導体チップの中心より遠ざけることも可能であるが、そのためには半導体チップの大きさそのものを大きくする必要が生ずる。このような大きな半導体チップでは不良箇所の生ずる可能性が高まり、高い歩留りで半導体チップを製造することが困難となるという問題がある。

〔発明の目的〕

本発明は、上記問題点を解決するためになされたもので、半導体チップの大きさを拡大することなく、しかも大形の導体接続を有する半導体装置を提供することを目的とする。

〔発明の構成〕

上記目的達成のため、本発明においては、互いに裏面どうしを面接した2種類の半導体チップを併え、一方の半導体チップはワイヤレスボンディングにより裏面引出導体に接続され、他方の半導体チップはワイヤボンディングにより前記裏面引出導体に接続するようにしており、半導体チップ

はやはり放射状となっているがその先端位置は導体12Aとシートのおそれがない程度の間隔を確保できる位置でとどまっている。この導体12Aは、半導体チップ14上にフェースアップで接続された半導体チップ16上のセリ18とワイヤ17によって接続されている。

第6図は本発明の他の実施例を示す中央断面図であって、第4図および第5図では2つの半導体チップ14および16の大きさが同じであったのに対し、この実施例ではワイヤレスボンディングで導体12と接続される下側の半導体チップ14'の大きさがワイヤ17により導体12と接続される半導体チップ16'の大きさよりも大きくなっている。このような構成ではあらかじめ2つの半導体チップを面接しておき、ワイヤレスボンディングを下の半導体チップの外周をガイドとして正面に行い、またワイヤボンディングを多段に行うことができる。

以上の実施例においては互いに裏面どうしを接着剤で接着した半導体チップを使用しているが、他の適当な手段により固定されるものであっても

よい。

また実施例では下側の半導体チップの基板との接合をはんだパンチを使用したフリップチップ方式で行っているが、ビームリード方式やTMA方式等のからゆるワイヤレスポンディングを使用することができる。

【発明の効果】

以上のように、本発明においては、互いに面どうしを固着した2種類の半導体チップのうち一方はワイヤレスポンディングで、他方はワイヤボンディングで基板上の導体に接続するようしているので、半導体チップ周辺に形成される導体の数を半導体チップの大きさを拡大することなく増加させることができ、面積効率が向上する。

また、小さな半導体チップを2種類使用しているので、目的を選択して組合わせることができ、はじめから大きな半導体チップで形成する場合と比較して歩留りを向上させることができ。

《 図面の簡単な説明 》

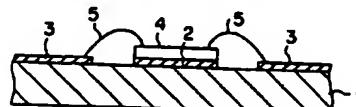
特開昭60-182731(3)

第1図ないし第3図は従来の半導体装置における接合の様子を示す中央断面図、第4図は本発明の一実施例の構成を示す中央断面図、第5図はその平面図、第6図は本発明の他の実施例を示す中央断面図である。

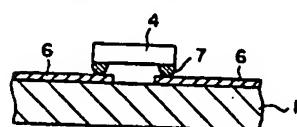
1, 11…基板、2, 3, 6, 9, 12…導体、4, 14, 16…半導体チップ、5, 17…ワイヤ、7, 13…はんだパンチ、15…接着剤。

出版人代理人 繁 胜 市

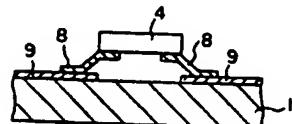
第1図



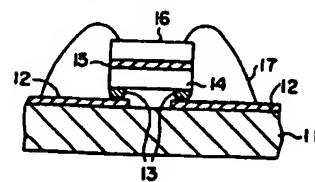
第2図



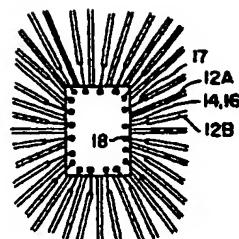
第3図



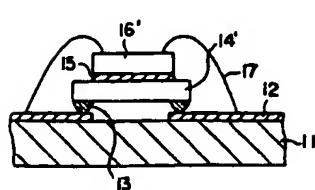
第4図



第5図



第6図



THIS PAGE BLANK (USPTO)